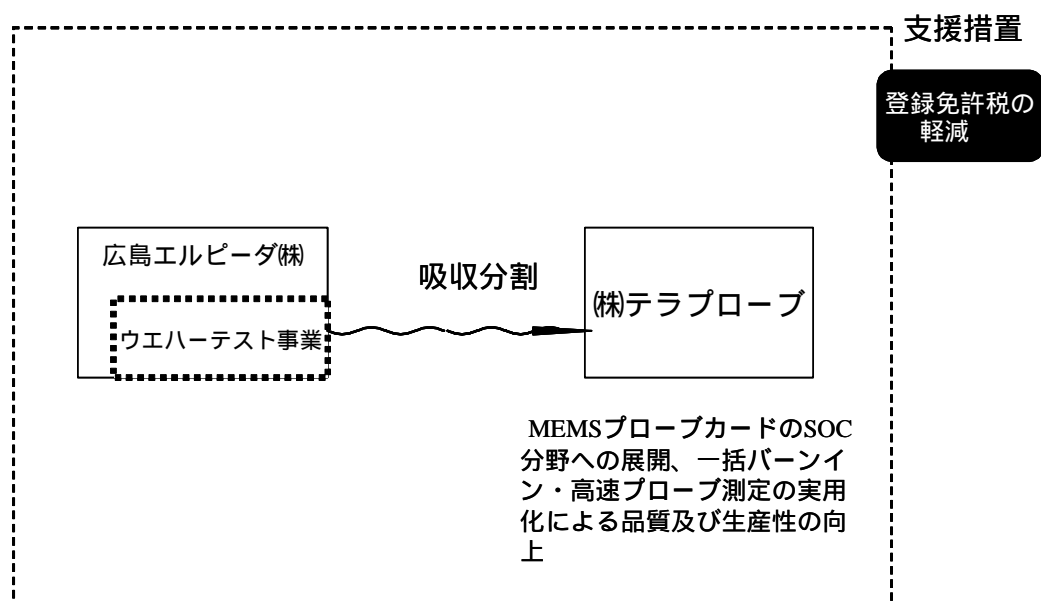


株式会社テラプローブの事業再構築計画のポイント

(株)テラプローブは、広島エルピーダメモリ(株)からウエハーテスト事業に関する設備等の資産を会社分割により包括的に承継し、その後の増資により最先端テスターへの投資と効率的な運用を進める。ウエハーテスト専門会社として、業界最先端のテスト技術力の確立と低コスト化を追求し、事業規模を拡大することで、更なる生産性の向上と競争力強化を目指す。



【生産性の向上】

- ・有形固定資産回転率を20.5%向上

【財務内容の健全性】

- ・有利子負債 / キャッシュフロー 10倍以内
- ・経常収支比率 100%以上

【事業革新】

- ・SOC製品につき業界で初めて多数個同時測定が可能となるMEMSプローブカードを本格量産に適用。また、一括バーンイン・高速プローブ測定を実用化。これら新技術を用いた新サービスの売上高を平成21年度には全売上高の19.1%とする。

【計画の実施期間】

- ・平成19年3月～平成22年3月

認定事業再構築計画の内容の公表

1. 認定した年月日 平成19年3月30日

2. 認定事業者名 株式会社テラプローブ

3. 認定事業再活用計画の目標

(1) 事業再構築に係る事業の目標

世界の半導体市場では、熾烈な市場競争の中で生産効率の向上によるコスト面での比較優位性を出すために、最先端の300mm工場に活発に投資を行っているが、その投資負担は巨額となっている、そのため、半導体メーカー各社は技術的な優位性が大きいウエハー製造工程へ資本を投下し、それ以外の組立工程及びテスト工程はアウトソーシングを進めることで機能的・水平的な分業体制を構築している。

上記のような世界的な潮流と比較して、これまでの日本国内の半導体業界においては、垂直統合がビジネスモデルの中心となっており、半導体メーカー各社は、コア領域であるウエハー製造工程以外の部分も含め、自社内で総合的に設備投資を行ってきた。それは大規模な投資を必要とする反面、投資額に見合った利益を生まないおそれがあり、大規模な投資を決定できないというジレンマを抱えるものであった。

しかし、こうした近年の世界的潮流により近年国内の各半導体メーカーにおいても、ウエハーテスト工程をアウトソーシングし、コアであるウエハー製造工程への設備投資集中の動きが出てきている。

当社は今後日本の半導体メーカーにおいても、ウエハーテスト工程のアウトソーシングがより急速に進展していくと想定しており、現在主力のDRAM向けテストの他、テスト分野をSOCやフラッシュメモリ向けテストまで拡大していくことを計画しており、ウエハーテストサービスの形態として新しいモデルであるオンサイトサービス（顧客工場敷地内においてテストを行う形態であり、顧客の既存従業員・フロアの有効活用を可能とする）と既存のモデルであるオフサイトサービス（テラプローブ敷地にて行うテストサービス）を提供していく予定である。

当社は、これまで培ってきたウエハーテストのノウハウをベースに後述の技術革新を実現することにより、ウエハーテストを通して顧客のコストダウン及び高品質ウエハー製品の製造の実現に寄与していく計画である。しかしながら、新たなビジネスモデルであるオンサイトサービスを今後主力として事業を継続・展開していくためには、同時に既存のビジネスモデルによるサービスの提供も必須であり、両者を併存してユーザーに最適なサービスを提供する事を目標としている。

目標の達成には、顧客工場における設備投資と当社事業所におけるテスト設備の効率的な配置が必要である。効率的な設備配置を目指してこれまでも設備投資を行っているが、既存の設備の効率的な配置も課題として残っている。現在、当社の主要な半導体検査・測定装置並びに附属設備等は、広島エルピーダメモリ㈱から賃借している。これらについても効率的な運用が求められているものの、賃借設備であることから使用目的が限定されており、効率的な設備の配置がなされないでいる。

これらの課題を解消するためには、会社分割により当社に承継し自社所有とすること、並びに確固とした事業の安定的基盤を確保するために、主要な人材が出向者で占められている現状を解消する方法としての人員転籍が必要であると判断した。

今回の事業再構築計画の骨子は、当社が事業の用に供している広島エルピーダメモリ㈱から賃借している主要設備を会社分割により承継し、それらを自社所有として独自で運用すること及びエルピーダメモリ㈱並びに広島エルピーダメモリ㈱から出向し、現在当社でテストオペレーションを実施している従業員を転籍することにより、当該設備の稼働率向上やオペレーションノウハウの承継を始めとしてテスト工程事業の競争力強化を図り、技術革新の実用化を行うものである。

また、急速な事業の拡大を計画していることから、顧客の所要を充足する受託能力を備えるためには、最新の半導体検査・測定装置への設備投資が不可欠であり、その設備

投資資金を確保するために増資を実施する予定である。

(2) 生産性の向上を示す数値目標

生産性の向上としては、平成21年度には、有形固定資産回転率を平成17年度と比較して20.5%向上させることを目標とする。

4. 認定事業再構築計画の内容

(1) 事業再構築を実施するための措置の内容

中核的事業

半導体製品のウエハーテスト事業

選定理由

当社は、エルピーダメモリ(株)及び広島エルピーダメモリ(株)のウエハーテスト事業を承継し、同社の最先端の300mm工場で展開されている確かな技術的実績のあるウエハーテスト技術の供与を受けたウエハーテスト専業会社としてスタートした。

現在は半導体メモリであるDRAMのウエハーテストが主力であるが、この技術をベースとして、Logic等DRAM以外の半導体製品のウエハーテスト及びファイナルテストの展開も開始している。またLogicでの実績を踏まえ、今後SOC及びフラッシュメモリ等、より広範囲な半導体ウエハーテストへの展開が十分可能である。

さらに近年、携帯電話及びデジタル家電等、半導体製品の高機能化・小容量化のニーズが高まり、複数チップの単一パッケージ(MCP: Multi Chip Package)化が進展しており、パッケージング前の半導体チップの品質を確保するためのウエハーテストの重要性が高まりつつある。

このように、ウエハーテスト事業の中期的展開余地は非常に大きく、当社の収益の柱であると同時に、当社の中核的事業である。

事業再構築に係る事業の内容

広島エルピーダメモリ(株)から会社分割によりウエハーテスト事業に係る設備・装置等の資産を承継し、それらの独自運用を行い、稼働率の改善及び事業活動の効率化を図る。

(事業の構造の変更：会社の分割)

分割会社

名称 広島エルピーダメモリ(株)

住所 広島県東広島市吉川工業団地7番10号

代表者の氏名 代表取締役 坂本 幸雄

資本金 325百万円

承継会社

名称 (株)テラプローブ

住所 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

代表者の氏名 代表取締役 小澤 雅英

分割前の資本金 5,600百万円

分割後の資本金 9,600百万円

分割により新たに発行される株式を引き受ける者

広島エルピーダメモリ(株)

分割期日

平成19年3月31日

(事業の構造の変更：資本の相当程度の増加)

増加前資本金：96億円

増加する資本金

第一次及び第二次：100 億円（予定）

第三次：50 億円（予定）

増資の時期

第一次及び第二次：平成 19 年度（予定）

第三次：平成 21 年度（予定）

増資の方法

第一次及び第二次：未定

第三次：未定

（事業革新）

当社では、DRAM のウエハーテスト事業を通して蓄積してきた技術資産をベースに Logic 半導体製品へのウエハーテスト、パッケージ製品のテストサービスを開始しており、更に SOC、フラッシュ等の半導体製品への展開を拡大すべく、以下の項目に関する技術開発及び実用化に注力して取り組んでいる。

MEMS プローブカードの SOC 分野への展開による生産性の改善

SOC 製品につき業界で初めて多数個同時測定可能な MEMS プローブカードを平成 19 年度下期より本格量産に適用する予定である。期待する効果としては適用前と比較して、生産性が 1.5 倍から 1.7 倍程度改善され（テスター台当りの測定枚数増加）、顧客のコストダウンに貢献することで、SOC 製品のウエハーテスト市場における当社の存在価値を高め、市場占有率の拡大を図る。

一括バーンイン・高速プローブ測定の実用化による品質及び生産性の大幅改善

また DRAM 及びフラッシュ製品については携帯電話向けなど複数チップを単一パッケージにするため、各チップをパッケージレスで販売する市場が急速に伸長しており、従来パッケージング後にしか実施できなかった高速測定（At speed test）及び高温・高電圧等の加速試験（一括モニタバーンイン）を業界で初めて平成 19 年度下期からウエハーテストで実用化することにより、パッケージ品と同等の品質が確保されたウエハー製品の実現が可能となり、DRAM 及びフラッシュ製品のウエハーテストにおける当社の飛躍的なビジネス拡大が可能となる。

これらの結果、上記 ・ の新技術を用いたサービスの売上高を平成 21 年度には全売上高の 19.1%以上とすることを目標とする。

(2) 事業再構築を行う場所の住所

東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号

(株)テラプローブ

広島県東広島市吉川工業団地 7 番 1 0 号

(株)テラプローブ 広島事業所

熊本県芦北郡芦北町湯浦 1 5 8 0 - 1

(株)テラプローブ 九州事業所

(3) 関係事業者

該当なし

(4) 事業再構築を実施するための措置の内容

別表のとおり

(5) 事業再構築の開始時期及び終了時期

開始時期：平成19年3月
終了時期：平成22年2月

(6) 事業再構築に伴う労務に関する事項

事業再構築の開始時期の従業員数（平成19年2月末時点）

(株)テラプローブ 567名

注）常時使用する派遣社員等を含む。

(7) その他

該当なし

別表

事業再構築の措置の内容

措置事項	実施する措置の内容及びその実施する時期	期待する支援措置
事業の構造の変更		
<p>会社の分割による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上</p>	<p>分割会社 名称 広島エルピーダメモリ㈱ 住所 広島県東広島市吉川工業団地7番10号 代表者の氏名 代表取締役 坂本 幸雄 資本金 325百万円 承継会社 名称 (株)テラプローブ 住所 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 代表者の氏名 代表取締役 小澤 雅英 分割前の資本金 5,600百万円 分割後の資本金 9,600百万円 分割により新たに発行される株式を引き受ける者 広島エルピーダメモリ㈱ 分割期日 平成19年3月31日</p>	<p>租税特別措置法第80条 (認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)</p>
<p>資本の相当程度の増加による中核事業の開始、拡大又は能率向上</p>	<p>増加前資本金：96億円 増加する資本金 第一次及び第二次合計：100億円(予定) 第三次：50億円(予定) 増資の時期 第一次及び第二次：平成19年度(予定) 第三次：平成21年度(予定) 増資の方法 第一次及び第二次：未定 第三次：未定</p>	<p>租税特別措置法第80条 (認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)</p>

事業革新		
第2条第2項第2号イ	<p>当社では、DRAM のウエハーテスト事業を通して蓄積してきた技術資産をベースに Logic 半導体製品へのウエハーテスト、パッケージ製品のテストサービスを開始しており、更に SOC、フラッシュ等の半導体製品への展開を拡大すべく、以下の項目に関する技術開発及び実用化に注力して取り組んでいる。</p> <p>MEMS プローブカードの SOC 分野への展開による生産性の改善</p> <p>SOC 製品につき業界で初めて多数個同時測定可能な MEMS プローブカードを平成 19 年度下期より本格量産に適用する予定である。期待する効果としては適用前と比較して、生産性が 1.5 倍から 1.7 倍程度改善され（テスター台当りの測定枚数増加）、顧客のコストダウンに貢献することで、SOC 製品のウエハーテスト市場における当社の存在価値を高め、市場占有率の拡大を図る。</p> <p>一括バーンイン・高速プローブ測定の実用化による品質及び生産性の大幅改善</p> <p>また DRAM 及びフラッシュ製品については携帯電話向けなどパッケージレスの市場が急速に伸長しており、従来パッケージング後にしか実施できなかった高速測定（At speed test）および高温・高電圧等の加速試験（一括モニタバーンイン）を業界で初めて平成 19 年度下期からウエハーテストで実用化することにより、パッケージ品と同等の品質が確保されたウエハー製品の実現が可能となり、DRAM 及びフラッシュ製品のウエハーテストにおける当社の飛躍的なビジネス拡大が可能となる。</p> <p>これらの結果、上記 ・ の新技術を用いたサービスの売上高を平成 21 年度には全売上高の 19.1%以上とすることを目標とする。</p>	